

2015年2月6日



[証券コード] 4364 東証第二部

熱硬化型イミドオリゴマー（MI-イミド）サンプル提供について

当社は、独自開発した新規熱硬化型イミドオリゴマー”MI-イミド”のサンプル提供を開始いたします。

サンプル提供をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】

マナック株式会社 東京支社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8番4号 日本橋さくら通りビル6階

TEL : 03-3242-2561 FAX : 03-3242-2564

E-mail : sales@manac-inc.co.jp

担当 : 川西

以上

Your Best Partner



MANAC Incorporated

加工が易しいポリイミド！！

MI-イミドの特徴

硬化前

- ①易ハンドリング性(粉体で供給)
- ②易加工性(フィルムから成形品まで可能)
- ③良保存性(常温保存可能)

粉体で供給致しますので、溶媒に溶解してワニスとしたり、そのまま金型内で加熱・加圧成型して成形品としてご使用頂けます。

硬化後

汎用ポリイミド並み物性(Tg250°C以上)

耐溶剤性 耐薬品性 柔軟性 耐熱性

マナック株式会社 東京支社 MANAC Incorporated

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8番4号

日本橋さくら通りビル6階

TEL:03-3242-2561 / FAX:03-3242-2564

URL:<http://www.manac-inc.co.jp/>

Your Best Partner



熱硬化型イミドオリゴマー “MI-イミド” Thermosetting oligomeric imide “MI-IMIDE”

MIイミドは当社が独自開発した新規熱硬化型イミドオリゴマーです。

“MI IMIDE” is original thermosetting oligomeric imide resin

(下表は一般的データで保証値ではありません)

* 特徴 Characteristics

- 独自の熱硬化システムにより、従来のポリイミドと比較して短時間で硬化することが可能です。
Easy processing, and Short curing term
- 硬化前Tg <150°C → 硬化後Tg>260°C
Initial Tg < 150 °C → after curing Tg>260 °C
- 得られる硬化物はポリイミドに匹敵する物性を示します。
Comparable properties to conventional polyimide films
- 加工前のMIイミドは室温保管が可能です。
Keeping at room temperature
- 各種繊維、フィラーを使用した複合化も出来ます。
Composite available using various fibers or fillers

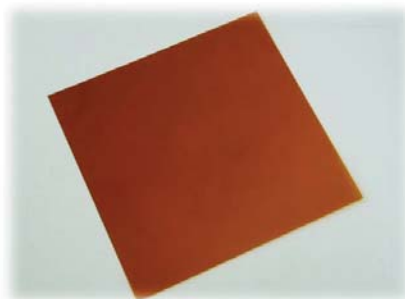
* 用途 Application

- 耐熱接着剤
Heat resistant adhesive
- 複合材料
Composite materials
- 各種インク用途(インクジェット、PE 等)
Ink for several applications (Ink jet, Printable electro device e.t.c.)

Properties of cured resin			
Tensile Modulus	GPa	2.2	
Tensile Strength	MPa	91	
Elongation at Break (Max)	%	9.7	
(Ave)	%	7.9	
Dielectric Constant	-	3.3	ASTM D150
Dissipation Factor	-	0.0093	ASTM D150
Volume Electrical Resistivity	Ω·cm	2.59×10^{17}	ASTM D257
Moisture Absorption	%	1.4	
Coefficient of thermal expansion	ppm/K	56	(TMA)
Glass transition temperature (initial)	°C	147	(DSC)
(cured)	°C	262	(DMA)
5% Weight Loss	°C	525	(TG-DTA)



粉体 Powder



シート Sheet



ワニス Vanish

マナック株式会社 東京支社 MANAC Incorporated

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8番4号

日本橋さくら通りビル6階

TEL:03-3242-2561 / FAX:03-3242-2564

URL:<http://www.manac-inc.co.jp/>

Your Best Partner



熱硬化型イミドオリゴマー “MI-イミド”

Thermosetting oligomeric imide “MI-IMIDE”

* 応用例 “プレート”

Example of application “Plate”

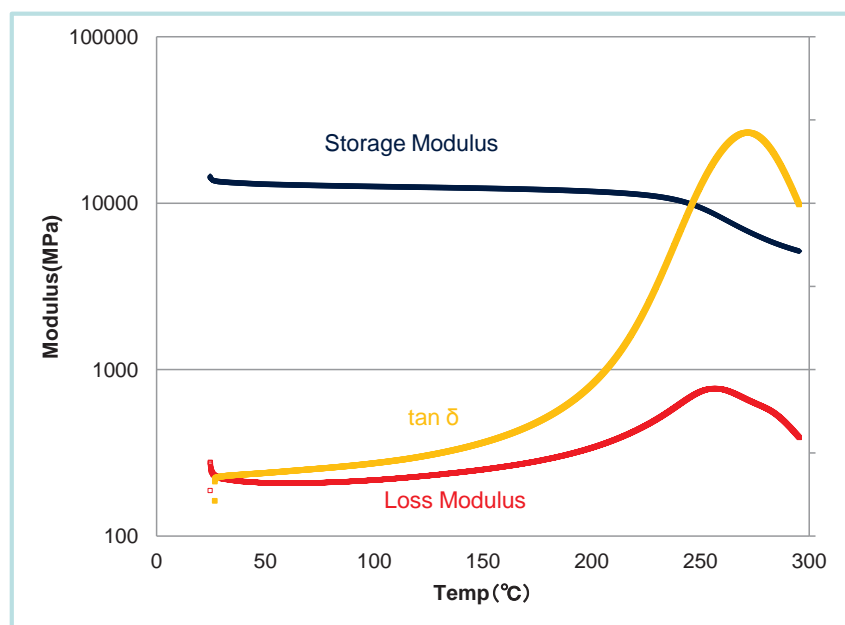
(下図は一般的なデータで保証値ではありません)

* 特徴 Characteristics

- CTE(X-Y)=28ppm/K
- 硬化後基板のTg=250°C
Tg=250 °C after curing
- ハロゲン、リンフリーの環境対応材料
Halogen and phosphorus free material

* 用途 Application

- 半導体検査部品
Semiconductor inspection equipments parts
- 電気絶縁部品
Electric insulation parts



DMA curves



プリプレグ Prepreg



銅張積層板 CCL (copper clad laminate)

マナック株式会社 東京支社

MANAC Incorporated

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目8番4号

日本橋さくら通りビル6階

TEL:03-3242-2561 / FAX:03-3242-2564

URL:<http://www.manac-inc.co.jp/>